

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（网络及电话会议） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）</p>	<p> 璞瑜资本、海南世纪前沿私募、广东正圆私募、西南证券、诺安基金、恒泽私募、Teng Yue Partners LP、创金合信基金、摩根基金、新华基金、光大永明资管、中信证券、浙江益恒投资、交银施罗德基金、同泰基金、博时基金、北京神农投资、中银基金、天风证券、华安基金、中国人保资管、中华联合财产保险、国投瑞银基金、西部利得基金、新华资管、南方基金、华泰资管、泰康资管、兴业基金、万泰华瑞投资、淡水泉、申万菱信基金、民生加银基金、上海潼骁投资、平安基金、POINT72 ASSOCIATES, LLC、上海综艺控股、长信基金、九泰基金、银河基金、上银基金、永赢基金、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、浦银安盛基金、上海聚鸣投资、华泰保兴基金、上海深梧资产管理、博裕资本、深圳猎投资本、广发证券资管、富国基金、汇添富基金、太平基金、榕树投资、中银国际、乾元资产、深圳前海华杉投资、中金资管、Willing Capital Management Limited、中科沃土基金、国泰基金、斌诺资管、闻天私募、MY. Alpha Management HK Advisors </p>

	Limited、中才中环投资、丹羿投资、鹏华基金、西部证券、财通证券资管、建信基金、华夏久盈资管、诺德基金管理、青榕资管、景顺长城基金、诺德基金、彤心雕珑私募、长城财富资管、汇华理财、香港鲍尔太平、Value Partners Limited、合道资管、英睿投资、招商基金、中英人寿保险、汇丰前海证券、阳光资管、煜诚私募、盘京投资、中信保诚基金
时间	2026年3月30日 10:00-11:00
地点	网络及电话会议
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 财务总监：贺剑青 证券事务代表：陈炜亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2025 年度经营情况：</p> <p>2025 年，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力”主线，坚定聚焦通用服务器、AI 服务器、交换产品，以及加速卡等算力 PCB 市场，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升，2025 年实现年营收 54.85 亿元，同比增长 46.89%，实现净利润 10.16 亿元，同比增长 50.24%。</p> <p>(1) 坚持聚焦算力应用，围绕战略目标，我们成功推动算力核心客户的认证流程，为后续深度合作奠定坚实基础。各部门紧密协同，全力配合客户完成审查流程并为量产订单转化积极做好各项准备。</p> <p>(2) 我们紧密跟随全球算力技术路线图，围绕新一代算力产品及工艺开展各项研发工作。在通用服务器领域，</p>

我们完成了 PCIE6.0 平台的转批量能力，在 AI 服务器领域，完成了 PCIe 交换板（30L+）、UBB/IO 板（28L-46L）、OAM 板（18L+，2 阶-8 阶 HDI）、GPU 主板（24L6 阶 HDI）、中置背板（N+M/N+N 技术）等一系列高端产品的工艺能力认证，在数据中心交换机领域完成了 400G&800G 交换机板的量产。在工艺技术研发方面，在多孔对准度能力提升、6mm 厚板钻孔、30:1 高厚径比电镀、背钻对准度 D+4 及 stub 控制工艺等关键工艺能力取得突破，为进一步提升、优化产品结构打下坚实的基础。

（3）广合科技坚持构建新质生产力，作为公司主力制造基地的广州广合，2025 年持续技改提升瓶颈工序的产能、工艺能力。不断提高广州广合的数字化程度，不仅实现了技术能力的提高也实现了产能的提升，产品结构不断优化，交付竞争力显著增强。报告期内，广州广合伴随营收规模提升的同时，保持了较高的盈利能力，不仅实现业绩指标的高速增长，同时各项运营效率指标健康。公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效，报告期内实现扭亏为盈。泰国广合 2025 年 6 月正式投产，12 月实现月度盈利，盈亏平衡周期仅仅用了 6 个月，实现当年投产当年盈利。报告期内，泰国广合按原定计划完成了核心客户的审核认证，伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国工厂一期产能的释放，泰国广合正在成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎。

二、从产能角度看，公司目前的产能规划是怎样的？
未来三到五年，广州、黄石和泰国的产能会达到多少？

2026 年预计黄石产值在 15 亿左右，泰国产值超 10 亿，广州 60 亿左右。今年已经实质在推进的扩产计划有广州一二厂的持续技改项目、三厂新建项目，泰国一期第二阶段投资项目以及二期建设项目，这几个项目的产能释放主要会体现在 2027 年，这些在推进扩产项目能够支持公司 2027 年依然保持快速的增长。至于其他的扩产计划及新建项目会根据客户的订单需求适时推出，后续可以关注公司相关公告。

三、公司泰国厂房目前盈利水平如何，盈利能力较高的原因是什么？

广合泰国 2025 年 6 月底正式投产，2025 年 12 月实现月度盈利，盈亏平衡周期仅用了 6 个月，在供应链配套不完善、人才短缺的客观条件下实现这个成绩非常不易，目前泰国广合爬产进度顺利，目前正积极推动一期第二阶段投资以及二期工程建设。2026 年泰国广合将实现盈利，因泰国广合产品定位为服务器主板、数据中心交换机板等高性能 PCB 产品，而且其主要服务海外客户，因此在产能利用率提升之后具备较强的盈利能力，具体盈利情况请关注后续的定期报告。

四、从客户来看，公司通用服务器和 AI 服务器的主要客户有哪些，几大客户分别贡献了多少收入占比？

公司前五大客户营收贡献占公司营收的 60.74%，最大客户占公司营收 20.20%，从客户集中度角度而言，收入结构非常健康，不存在对单一客户形成业务依赖的情

况。全球排名前十的服务器制造商，有八个是广合科技的客户，未来三年，我们目标是排名前十的服务器制造商做到全覆盖。因商务合作条款限制，我们不方便公开披露具体客户的名称。

五、公司 26 年及未来的资本开支是如何规划的，相应的投入产出比是多少？

2026 年预计资本开支 50 亿左右，投入产出比按照项目满产后的产值数据大概是 1:2，但项目产值的爬升受市场变化、客户订单、自身工艺能力提升等因素影响，会有一个逐步释放的过程，这个过程存在一定的不确定性。

六、上游原材料价格的上涨对公司去年全年和未来几个季度公司盈利能力有看到影响吗？

2025 年，铜、玻纤布、金盐等原材料价格受大宗商品上升影响，较去年同期出现一定涨幅。公司核心业务以服务器 PCB 为主，而高速板料受大宗商品价格波动的影响相对较小。后续公司会密切关注大宗商品价格的未来走势，加强上下游供应商、客户的沟通与协作，并通过内部降本增效、优化产品结构等手段来降低原材料成本上升对经营的影响。

七、随着 Agent 发展，CPU PCB 增速可能超预期，公司现在是否看到这样的趋势？如何展望未来几年 CPU PCB 的行业和公司增速？

从 2025 年四季度开始 CPU 主板的订单量同比有所增长，目前这个趋势依然持续，但我们目前尚不确认这个需

求增长是因为 Agent 的需求拉动，从业务部门反馈的情况看这部分订单需求比较乐观，对未来订单增长的持续性我们也在保持关注。

八、CPU PCB 订单旺盛，产能紧缺，公司是否看到有 CPU 转单现象出现？

AI 应用对高端 PCB 产能的消耗是巨大的，未来很长一段时间高端 PCB 的产能依然会比较紧张，算力产品的交付要求又高，因为产能不足导致的供应链之间订单外溢的情况是不可避免的。但算力产品对稳定性、可靠性的要求非常高，从商务合同上讲是不允许转单情况发生的，广合自身不存在转单的情形。

九、公司 AI CPU 的主要客户有哪些？25 年贡献的收入占比如何？

公司不方便透露具体客户的名称，25 年总体 AI 类产品的收入 12 亿左右，约占主营业务收入的 24%。

十、公司也在持续突破 GPU 相关板子，请问公司在 AI GPU 相关的板子上的产品进展如何？预计何时起量？

公司自 2024 年开始大量参与了 AI 服务器中的 SWITCH、UBB、加速卡、背板、数据中心交换机板等产品的送样及工艺能力认证，项目进展比较顺利，预计今年下半年开始 AI 类产品的占比会有明显增长。

十一、公司未来 AI CPU 和 GPU 方面的战略规划如何？

CPU 是公司的存量业务，供应链成熟稳定，这部分业务公司会围绕客户需求积极配合做好供给，GPU 作为增量

	<p>业务，是公司业务开拓的重点，从技术研发、产能配置各方面积极做好准备，尽快提升这部分产品的市场份额和业务占比。</p> <p>十二、公司预计 PCIE5.0 到 6.0 的代际转换会在哪一季度体现，对于 PCB 的单价和需求会有怎样的带动？</p> <p>Pcie5.0 到 Pcie6.0 的代际切换预计从 2026 年 3 季度开始，Pcie6.0 从材料到工艺相比 Pcie5.0 产品均会有明显的升级，因此订单单价也将会有明显提升。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>